

與您探討半導體新製程 Adwill 提供全方位封裝製程技術

「琳得科有可以對應晶圓級封裝製程(WLP)的設備嗎?」、「你們的膠帶是否符合環保需求?」在展會上，總會聽到來自客戶、同業夥伴對於半導體封裝製程的需求。

隨著無線通訊技術的進步及普及，對於穿戴式電子產品及物連網應用的要求越來越高，為符合產品輕薄小巧、易於攜帶的需求，對於晶片的小型化要求越來越高。Adwill 體察客戶需求並洞悉產業趨勢，於展會展出極薄晶圓用晶片背面保護膠帶，以及環保型切割膠帶和 RAD-3520 全自動研磨膠帶貼合機。

為響應綠色環保概念，琳得科採用獨家的黏著技術，開發出不使用鄰苯二甲酸酯的「環保型切割膠帶 D-175D」以符合 RoHS2.0 規範；D-175D 與 D-486 的基材材質分別為 PVC 及 PO。此膠帶具有良好的黏著力，於切割時可確實保持並固定晶片，經紫外線照射，降低黏著力以提升撿晶作業效率，並可抑制晶片 Chipping 及殘膠等問題發生。提升切割製程效率並減少對環境的污染。

在消費性電子產品的小型化和提升晶片效能的趨勢下，晶圓級封裝(WLP)及扇外型晶圓級封裝(FOWLP)等新封裝技術已成主流。新開發機台 RAD-3520 採用膠帶張力控制及回報方式，實現錫球晶圓及極薄晶圓高穩定性貼合作業，在研磨製程中保護晶圓的電路功能不受影響。研磨製程後的晶圓顯得更脆、易碎，RAD-3520 不僅降低搬運時晶圓的破損問題，更大幅提升作業性能(UPH100)並縮小佔地面積。

Adwill 提供客戶全方位的製程提案，從研磨用表面保護膠帶、切割膠帶、晶片背面保護膠帶到 RAD 系列膠帶貼合機一應俱全。透過膠帶與設備的整合方案，提升半導體封裝製程的穩定性。

